# LiNbO3 基板上における Cr2O3 薄膜の作製 Production of the Cr2O3 thin films on LiNbO3 Substrates

中村拓未<sup>1</sup>, 黒田卓司<sup>2</sup>, 岩田展幸<sup>3</sup>, 山本寛<sup>3</sup>
\*Takumi Nakamura<sup>1</sup>, Takuji Kuroda<sup>2</sup>, Nobuyuki Iwata<sup>3</sup>, Hiroshi Yamamoto<sup>3</sup>

Abstract: Undertake the annealing process to obtain step-terraces structure of c- and r-cut LiNbO<sub>3</sub>(LNO). The bunching step appeared at 900°C on c-cut LNO. The single step lattice height (0.23nm) is observed at 800~850°C, however, the step-line is wavy. The linear groove is observed at 700°C, however, the step not appeared. Particulate tall have been deposited on the surface of the substrate. Annealing superimposed together two surfaces of the substrates. I similar results are obtained when no overlap. The single step lattice height (0.40nm) is observed at 700°C, however, the step such as fibers appear.

1. 背景

強磁性 (Ferromagnetism : FM)/反強磁性 (Antiferromagnetic : AFM)積層膜界面における磁気的交換 相互作用によって, FM の磁化曲線がシフトすることが知 られている.このシフトする磁場を交換バイアス磁場 ( $H_{EB}$ )と呼ぶ. Meiklejohn-Bean によると,  $H_{EB}$ はAFM 表面の スピンの大きさに比例する<sup>[1]</sup>.単結晶と同等な薄膜を作製 すると必ず表面はステップ-テラス構造を示す.ほとんど のAFM 材料ではステップによって高さの異なったテラス のスピンは反強磁性的に配列している.一方, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜の r 面は,その表面がステップ-テラス構造を示したとしても, すべての面でスピンは強磁性的に配列しており,大きな  $H_{EB}$ を得る可能性がある.そのためには, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜表面が 原子レベルで平坦である必要がある.

これまで、DC-RF マグネトロンスパッタ法を用いてr面 および c 面サファイア基板上に, 基板温度 580~840℃, O2/Ar=2/8(ccm)~30/3(ccm), 内圧0.3-0.4Pa, 成膜時間2時間 で Cr2O3 薄膜を作製し、それぞれの結晶成長の違いについ て解析を行ってきた. r 面配向 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜表面は, 一つのグ レイン内ではステップ-テラス構造およびバンチングステ ップを確認したが、それ以外の箇所では深さ15-30nmの深 い溝が発生した.c面配向Cr2O3薄膜表面は成膜温度を変化 させても nm オーダーで平坦であった. 逆格子マップの結 果からc面配向膜は双晶を含み、r面配向膜は双晶を含まず 成長したことが解った. これは基板との格子ミスマッチに よる結晶歪みの影響を受けたためであると考えた. そこで 結晶構造、格子ミスマッチの観点からより適切な基板とし て, LiNbO<sub>3</sub>(LNO)基板を選択した. 格子ミスマッチは, c 面 では, +4.01%(サファイア)から-3.77%(LNO), r 面では +4.01%, +4.34% (サファイア)から-3.77%, -2.52%(LNO)とな り、格子歪みの影響が緩和される可能性がある.よって c 面では双晶の成長, r 面では溝の発生が抑えられる可能性 がある.

#### 2. 目的

表面が原子レベルで平坦であり、双晶を含まない  $Cr_2O_3$ 薄膜を作製するには、LNO 基板上に成膜することで得られ ると考えた.よってその準備として LNO 基板の熱処理最 適条件探索を行った.

### 3. 実験方法

*c*面LNO 基板をアセトン5分,15分, エタノール5分で 超音波洗浄を行った.熱処理条件として,温度 (a)900℃,(b)850℃,(c)800℃,(d)700℃,12時間大気中で熱処理 処理を行った.また,二枚の基板表面同士を重ねて温度 700℃,12時間大気中で熱処理を行った.*r*面LNO 基板をア セトン5分,15分, エタノール5分で超音波洗浄を行い,温 度700℃,3時間大気中で熱処理を行った.

#### 4. 結果

図 1 に熱処理後の, 温度ごとの c 面 LNO 基板表面像 (1×1µm<sup>2</sup>)を示す. 熱処理温度 900°C ではステップテラス構 造及びバンチングステップを確認したが, ステップは直線 状ではなかった. 800°C~850°C では1 格子高さのステップ (高さ 0.23nm)が明瞭に確認できた. しかしステップは湾曲 した形状となった. 700°C では直線状の溝を確認したが, ステップは確認できなかった.

また,熱処理後の LNO 基板表面に背の高い粒子が現れ ていた.この微粒子が熱処理環境下周辺から飛来した微粒 子であるのか,熱処理することによって基板から析出した 微粒子であるのか不明である.そこで二枚の LNO 基板の 表面同士を重ねて熱処理することで確かめた.

図2に基板を重ねて温度700℃で熱処理したときのc面 LNO 基板表面像(5×5µm<sup>2</sup>)を示す. 図2より, 重ねていない 時のLNO 基板表面と同様の結果を得た.

図 3 に温度 700℃ で熱処理した r 面 LNO 基板表面像

239

(1×1µm<sup>2</sup>)を示す. 図 3 より繊維状のステップを確認した. ラインプロファイルによりステップの高さを測定した結 果,約0.40nm であった.



図1 熱処理温度ごとの c 面 LNO 基板表面像(1×1µm<sup>2</sup>)



0 nm 18.03 図 2 二枚の *c* 面 LNO 基板の表面同士を重ねて 温度 700℃ で 12 時間熱処理した基板の表面像(5×5µm<sup>2</sup>)



図3 温度 700℃ で3 時間熱処理した r面 LNO 基板の表面像(1×1µm<sup>2</sup>)

## 5. 考察

図1より,c面LNO 基板では熱処理の温度が高くなると ステップの形状は湾曲して、バンチングすることがわかっ た. これは熱処理の温度が高くなると原子の拡散距離が長 くなるためであると考えられる. また温度 800℃ では一格 子高さのステップが現れているのに対して, 700 ℃ ではス テップが現れなかった. この結果から, c 面 LNO 基板の熱 処理の最適温度は 700℃ から 800℃ の間であると考えられ る. また,基板表面に現れた微粒子は,熱処理環境下周辺 から飛来した微粒子であるか,熱処理することによって基 板から析出した微粒子であるかの二通り考えられたが,図 2 より飛来してきた微粒子ではないことがわかった. よっ てこの微粒子は基板から析出して来たものであると考え られる.

図3よりr面LNO 基板上には繊維状のステップが現れ ていた.これは、熱処理の時間が3時間と短く、ステップ の形成が途中でとまってしまったためであると考えられ る.また、熱処理後のr面LNO 基板上には微粒子が出現し ていなかった.このことから、c面LNO 基板でも熱処理時 間を短くすれば微粒子が出現しない可能性があると考え られる.今後は更にLNO 基板の熱処理最適温度条件を探 索し、その上に $Cr_2O_3$ 薄膜を成膜する.

#### 6. まとめ

LNO 基板の熱処理最適条件探索を行った.c 面において、 熱処理温度900°Cではステップテラス構造及びバンチング ステップを確認した. 800℃~850℃ では、ステップを確認 した.しかしステップは湾曲した形状となった.これは熱 処理の温度が高くなると原子の拡散距離が長くなるため であると考えられる. 700℃ では直線状の溝を確認したが、 ステップは確認できなかった.また、二枚のLNO基板の表 面同士を重ねて熱処理を行った. その結果, 重ねていない 時の LNO 基板表面と同様であった. よってこの微粒子は 基板から析出して来たものであると考えられる. r 面にお いて温度 700°C では繊維状のステップを確認した. これは 熱処理の時間が3時間と短く、ステップの形成が途中でと まったためであると考えられる. これらの結果より, c 面 LNO 基板の熱処理の最適温度は 700℃ から 800℃ の間で あると考えられる. 今回の実験で熱処理した LNO 基板で は、表面が原子レベルで平坦な Cr2O3 薄膜を得ることは難 しい. よって更なる熱処理最適条件探索が必要である.

7. 参考文献

- [1] W. H. Meiklejohn and C. P. Bean, Phys. Rev. 5 (1956) 1413-1414.
- [2] Ch. Binek, A. Hochstrat, and W. Kleemann, J. Magn. Magn. Mater. 234 (2001) 353-358.